

GLOSAR -ABREVIERI

ASIC - Application Specific Integrated Circuit.
BCT – Back Contact Termination (tip terminal);
CPU Unitate de Calcul Centrala
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor (tehnologie MOS complementară)
CS – Chip Select (selectare circuit);
DIP – Dual Inline Package (capsulă cu două rânduri de pini);
DSP (Digital Signal Processor);
FP- Flat Package (capsulă cu terminale pe toate cele patru laturi);
GPS – Global Positioning System (poziționare globală prin satelit);
H – High (înalt – nivel logic);
IEC - International Electrotechnical Commission (comisia internațională de electrotehnică);
INC – Increment (incrementare);
IO - Input Output
ISDN – Integrated Services Digital Network (rețea digitală cu integrarea serviciilor);
L – Low (jos – nivel logic);
LCD – Liquid Crystal Display (afișaj cu cristale lichide);
LDR – Light Dependent Resistor (resistor dependent de lumină – fotorezistor);
LED – Light Emission Diode (diodă electroluminiscentă);
LTCC – Low Temperature Cofired Ceramic (ceramică cu temperatură joasă de sinterizare – tehnologie MCM);
MCM - Multichip Module (modul multichip – tehnologie) ;
MCM-C – Multichip Module Ceramic (modul multichip ceramic – tehnologie) ;
MCM-D – Multichip Module Thin Film Deposited (modul multichip folosind tehnologia straturilor subțiri – tehnologie);
MCM-L – Multichip Module Laminated (modul multichip laminat – tehnologie);
MPU (MicroProcessor Unit)
MOS – Metal Oxide Semiconductor (metal oxid semiconductor – tehnologie);
MR – Magnetorezistor;
NMOS - N Metal Oxide Semiconductor (tehnologie MOS cu canal n);
NTC – Negative Temperature Coefficient (coeficient negativ de temperatură);
PTC – Positive Temperature Coefficient (coeficient pozitiv de temperatură);
RAM – Random Access Memory (memorie cu acces aleator);
ROM – Read Only Memory (memorie numai pentru citire);
SCL – Serial Clock (tact serial);
SDA – Serial Data (dată serială);
SIP – Single Inline Package (capsulă cu un rând de pini);
SMD – Surface Mount Device (dispozitiv pentru montare pe suprafață);
SMT – Surface Mounted Technology (tehnologia montării pe suprafață);
SOIC – Small Outline Integrated Circuit (circuit integrat cu capsulă redusă);
TCR – Temperature Coefficient of Resistance
THT – Through Hole Technology (tehnologie prin inserție);
TS – Top Surface (tip terminal);
TS-BM – Top Surface and Bottom Metallization (tip terminal);
TSG – Tehnologia straturilor groase;
TSS – Tehnologia straturilor subțiri;
TV – Televiziune;
U/D – Up/Down (înainte-înapoi – numărător);

USB – **U**nit **S**erial **B**us (port universal serial);
VCR – **V**oltage **C**oefficient **R**esistor (coeficient de variație a rezistenței cu tensiunea);
VDR – **V**oltage **D**ependent **R**esistor (resistor dependent de tensiune – varistor);
VLSI – **V**ery **L**arge **S**cale **I**ntegration (integrare pe scară foarte largă);
WA – **W**rap **A**round (tip terminal);
WCR – **W**iper **C**ounter **R**egister (registru numărător cursor).